

杭州士兰微电子股份有限公司  
2015 年年度股东大会  
会议资料



## 会议资料目录

1、《2015 年年度报告》及摘要	第 3 页
2、《2015 年度董事会工作报告》	第 3 页
3、《2015 年度监事会工作报告》	第 11 页
4、《2015 年度财务决算报告》	第 13 页
5、《2015 年度利润分配方案》	第 17 页
6、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》	第 18 页
7、《关于续聘 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》	第 19 页
8、《关于本公司 2016 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	第 19 页
9、《关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案》	第 20 页
10、《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》	第 21 页

议案之一：

**2015 年年度报告及摘要**

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

议案之二：

**2015 年度董事会工作报告**

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

**一、董事会日常工作情况**

**(一) 董事会召开情况**

2015 年公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了公司定期报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。具体情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
第五届董事会第二十次会议于 2015 年 1 月 23 日召开	审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；《关于对子公司增加担保额度的议案》；《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 3 月 8 日召开	审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；《2014 年度董事会工作报告》；《2014 年度监事会工作报告》；《2014 年度财务决算报告》；《2014 年度利润分配预案》；《2014 年度关于公司内部控制的自我评估报告》；《2014 年度社会责任报告》；《关于与友旺电子日常关联交易的议案》；《关于与士腾科技日常关联交易的议案》；《关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》；《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于本公司 2015 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；《关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案》；《关于 2014 年度高管薪酬的议案》；《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品

	的议案》；《关于公司股东分红三年（2015--2017）规划的议案》；《关于拟投资建设 8 英寸集成电路芯片生产线的议案》。
第五届董事会第二十二次会议于 2015 年 3 月 31 日召开	审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第二十三次会议于 2015 年 4 月 29 日召开	审议通过了《2015 年第一季度报告》；《关于以募集资金及自有资金向成都士兰增资的议案》。
第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 5 月 31 日召开	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第二十五次会议于 2015 年 6 月 26 日召开	审议通过了《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第二十六次会议于 2015 年 7 月 20 日召开	审议通过了《关于公司及控股子公司士兰集成分别向华能信托申请 1 亿元信托贷款融资额度的议案》；《关于与杭州士兰创业投资有限公司共同投资的关联交易的议案》。
第五届董事会第二十七次会议于 2015 年 8 月 4 日召开	审议通过了《关于办理融资租赁业务的议案》。
第五届董事会第二十八次会议于 2015 年 8 月 16 日召开	审议通过了《2015 年半年度报告》及摘要；《关于 2015 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第五届董事会第二十九次会议于 2015 年 8 月 19 日召开	审议通过了《关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案》；《关于对子公司增加担保额度的议案》；《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 29 日召开	审议通过了《2015 年第三季度报告》。

## （二）董事会专门委员会的工作

2015 年董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名与薪酬委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。审计委员会对公司年报等定期报告、财务报表及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范化管理水平的提高。提名与薪酬委员会在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略与投资委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项：按照股东大会的决议和授权积极组织推进短期融资券项目的申报；公告并实施完成了 2014 年度股东大会决议通过的利润分配方案；对股东大会决议通

过的年度日常关联交易、年度担保、购买理财、对外投资等重大事项，董事会对执行情况及时进行关注，保障公司规范治理和运营。

## 二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，在全球经济持续低迷，国内经济下行压力较大的背景下，公司生产经营活动总体上保持稳定。2015 年，公司营业总收入为 192,641 万元，较 2014 年同期增长 3.02%；公司营业利润为-4,105 万元，比 2014 年同期减少 135.25%；公司利润总额为 2,804 万元，比 2014 年同期减少 84.85%；公司归属于母公司股东的净利润为 3,988 万元，比 2014 年同期减少 75.74%。2015 年公司营业利润、净利润较去年同期减少较多的主要原因是：受 LED 芯片行业竞争加剧的影响，公司子公司士兰明芯在 2015 年出现了较大的亏损。

2015 年，公司集成电路的营业收入较去年同期增长 13.21%。驱动集成电路营业收入增长的主要因素是 LED 照明驱动电路出货量的大幅增加。同时，公司 AC-DC 驱动电路、IPM（智能功率模块）、MEMS 传感器产品等也呈现较快的增长态势。2015 年，公司分立器件产品的营业收入较去年同期增加 5.23%。分立器件产品中，MOS 管的销售增长较快，IGBT、FRD、TVS 等产品也呈现较快的增长态势。

2015 年，公司发光二极管产品的营业收入较去年同期减少 23.40%。发光二极管产品的营业收入减少的原因是：受市场竞争进一步加剧的影响，2015 年发光二极管的芯片价格出现较大幅度的下降。由于前些年国内各地对 LED 行业过度投资，造成目前国内 LED 芯片产能出现了较大的过剩，行业洗牌在所难免。2015 年，公司对士兰明芯业务进行了调整，一方面通过优化生产组织、进一步降低运行成本，另一方面通过积极开拓市场、加快资金周转。今后公司还将逐步加大投入，进一步提升公司产品的竞争力。2015 年，公司子公司杭州美卡乐光电有限公司通过降低产品成本，进一步提升了产品毛利率，保持了在高端彩屏像素器件市场的领先优势。

2015 年公司子公司士兰集成公司产出芯片 169 万片，比去年同期减少 6.11%。士兰集成芯片产出减少是由于春节期间设备停产检修、一季度芯片产出较少所致；通过加大技改投入，士兰集成进一步扩充了集成电路芯片的产能，目前士兰集成月产芯片数量已提高至 17 万片以上。经过长达十五年的建设，目前士兰集成年产芯片能力已经达到 220 万片以上，生产规模在中等尺寸（5 寸和 6 寸）芯片制造企业中位居前列。2015 年，公司子公司成都士兰公司模块车间已投入生产，功率器件和功率模块的封装产能得到进一步扩充。

2015 年，公司 8 英寸芯片生产线项目进展顺利。截止 2016 年 1 月末，主要生产厂房已结顶，部分生产设备已运抵公司。2016 年上半年将进行净化装修和机电动力设备安装，下半年将进行工艺设备安装及调试，预计 2017 年上半年将进入试生产阶段。今后，公司 8 英寸芯片生产线将主要定位在：（1）高压集成电路特色工艺的研发和生产；（2）高压高功率半导体芯片的开发和生产；（3）MEMS 传感器的研发和生产。8 英寸芯片生产线项目的实施，未来将有力地提升公司的制造工艺水平，进一步缩小与国际同类型半导体企业之间的差距；有助于强化公司的盈利能力，提升公司的综合竞争能力。

2016 年，公司将根据董事会提出的“聚焦细分市场，集中投入，以创新引领发展”总的指导思想，坚持走“设计和制造一体”的模式，在集成电路、特种功率器件、MEMS 传感器、LED 等多个技术领域持续加大投入；利用公司在多

个芯片设计领域的积累，提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案，不断提升产品质量和口碑，提升产品附加值。

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、行业竞争格局和发展趋势

###### (1) 国内半导体行业竞争格局

目前国外半导体产业向我国转移的趋势没有改变，我国已成为全球主要的半导体生产国家之一，但我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距。近些年，境外大型半导体公司在国内投资快速增长，外资厂商凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额，并在某些高端半导体设计和制造方面甚至处于垄断地位。我国半导体企业中从事代工业务的中小企业仍占多数，具有自主核心技术和先进生产工艺的企业较少，市场竞争手段以价格竞争为主。从半导体行业最为注重的规模效应来看，我国优势半导体企业仍亟待加强。

###### (2) 2015 年我国集成电路行业发展概述

受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及外资企业加大在华投资影响，2015 年中国集成电路产业保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计，2015 年中国集成电路产业销售额为 3,609.8 亿元，同比增长 19.7%，其中：国内集成电路设计业销售额为 1,325 亿元，同比增长 26.5%；国内芯片制造业销售额为 900.8 亿元，同比增长 26.5%；国内封测业销售额为 1,384 亿元，同比增长 10.2%。根据海关统计，2015 年进口集成电路 3,139.96 亿块，同比增长 10%；进口金额 2,307 亿美元，同比增长 6%。出口集成电路 1,827.66 亿块，同比增长 19.1%；出口金额 693.1 亿美元，同比增长 13.9%。2015 年进出口逆差 1,613.9 亿美元。目前，带动半导体市场高速增长的通讯、计算机产品因市场趋于饱和而增长乏力；但是，新兴市场（如汽车电子、医疗保健电子、物联网、存储产品等）的兴起且快速发展，为半导体市场的发展带来新的机遇。预计 2016 年中国集成电路行业仍将保持较快的增长速度。

##### 2、公司面临发展的战略机遇期

为鼓励和支持我国集成电路产业的发展，2011 年年初国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号，以下简称“国发 4 号文”）；2014 年 6 月，国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称《纲要》）。《纲要》明确提出：“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期”，“应充分发挥市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路

产业跨越式发展”，“为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。”《纲要》还提出要“设立国家产业投资基金。重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。”2015年6月国务院印发了《中国制造2025》发展战略规划（以下简称“规划”），“规划”提出：在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域，着力掌握关键核心技术，完善产业链条，形成自主发展能力。继续扩大开放，积极利用全球资源和市场，加强产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势，提升制造业开放发展水平。今后，随着《纲要》、“规划”的落实、“十三五”重点项目的实施、以及国家“供给侧改革”的推进，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

士兰微电子经过十多年的发展，坚持走“设计制造一体化”道路，在多个产品技术领域构建了核心竞争优势，尤其以 IDM（设计与制造一体）模式开发高压高功率的特殊集成电路、半导体功率器件与模块、MEMS 传感器等为特色。近几年，士兰微电子通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，这为公司今后可持续发展增添了动力。

随着半导体信息技术在节能环保、移动互联网、物联网、可穿戴设备、智能制造等领域的广泛的应用，半导体行业面临更为广阔的市场空间。士兰微电子将依托 IDM 模式，加快对智能功率模块、IGBT、电源驱动 IC、MEMS 传感器件等新产品的开发，大力推进系统创新和技术整合，不断提升产品的附加值，在创造良好经济效益的同时，积极创造社会效益。

## （二） 公司发展战略

公司发展战略和目标：成为国内领先的、有自主品牌的半导体产品供应商；走设计与制造一体的模式，在半导体功率器件、MEMS 传感器、LED 等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入；利用公司在多个芯片设计领域的积累，提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案；不断提升产品质量和口碑，提升产品附加值。

具体描述如下：

1、利用在控制芯片和功率器件的技术和成本上的优势，在 LED 照明驱动领域全力拓展，抓住该市场快速放大的时机，积极拓展高端品牌客户，提高市场占有率。同时将加快智能照明系统的芯片和应用方案开发。

2、在高压 BCD 工艺、高压半导体功率器件和模块的技术研发上加大投入，拓展和丰富以 IGBT 为代表的功率器件产品和智能功率模块产品，拓展这些产品在新能源、高效电机驱动、工业控制等领域的应用。

3、持续推进士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌的建设，积极拓展海内外高端客户，扩充产能，拓展新的高端应用市场。

4、加快推进 MEMS 传感器的市场开拓步伐，在三轴加速度传感器、三轴磁传感器推向市场之后，将陆续推出三轴陀螺仪、六轴惯性传感器和空气压力传感器等 MEMS 传感器产品，追上移动智能终端和穿戴式产品发展的步伐。

5、整合公司各产品线的技术优势（功率驱动、无线射频、MCU/DSP 控制），在智能照明、变频电机控制等领域推出完整应用方案和配套电路。

6、继续在数字音视频（含安防监控）领域投入，巩固并拓展应用市场。

7、持续在 LED 芯片领域投入，在 LED 彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上，加快发展高端照明 LED 芯片业务。

8、继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展。在国家集成电路产业基金的支持下，加快建设第一条集成电路 8 英寸芯片生产线，在特殊工艺领域坚持走 IDM（设计与制造一体）的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设，逐步实现投产。

### （三）核心竞争力分析

#### 1、较为成熟的 IDM 模式

公司从集成电路芯片设计业务开始，逐步搭建了芯片制造平台，并已将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块和 MEMS 传感器的封装领域，建立了较为成熟的 IDM（设计与制造一体）经营模式。IDM 模式可有效进行产业链内部整合，公司设计研发和工艺制造平台同时发展，形成了特殊工艺技术与产品研发的紧密互动，以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

#### 2、产品群协同效应

公司从集成电路芯片设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在半导体大框架下，形成了集成电路、功率半导体芯片、MEMS 传感器、LED 等业务的协同发展，各业务之间相互补充、促进、借鉴。比如进入 LED 业务之后，公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理经验，成为 LED 业务发展的后盾；再比如公司集成电路和 LED 这两个领域较为深入的技术理解和积累，开发出了高效的 LED 驱动电路。

#### 3、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。LED 电源驱动电路、各类 AC-DC 电源电路、MEMS 传感器产品、以 IGBT 为代表的功率半导体产品、高压集成电路和智能功率模块产品、美卡乐高可靠性指标的 LED 彩屏像素管等新技术产品都是公司近几年在这个技术研发体系中依靠自身的高强度投入和积累完成的。

公司的研发工作主要可分为两个部分：芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面，公司以 IPD（集成产品开发管理体系）为引导，依照产品的技术特征，将技术研发工作根据各产品线进行划分。目前主要分为电源与功率驱动产品线、MCU 产品线、数字音视频产品线、物联网技术与产品线、射频与混合信号产品线、分立器件产品线等。公司持续推动新产品开发和产业化，根据市场变化不断进行产品升级和业务转型，保持了持续发展能力。



在工艺技术平台研发方面，公司依托于士兰集成业已稳定运行的芯片生产线，建立了新产品和新工艺技术研发团队，陆续完成了国内领先的高压 BCD 工艺平台、槽栅 IGBT 工艺平台、超薄片工艺平台、MEMS 传感器工艺平台等，形成了有特色的特殊工艺制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性，另一方面也支撑了公司电源管理电路、功率模块、功率器件、MEMS 传感器等各系列产品的研发。

在 LED 芯片技术和封装技术领域，公司也建立了完整的研发团队和技术开发体系，投入了大量的技术研发力量，攻克了 LED 芯片的 ESD 防护、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD 外延参数均匀性、美卡乐 LED 封装品的可靠性、产品参数一致性等一系列关键技术，在提升产品品质的同时，有效地降低了生产成本。

#### 4、面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系，依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得了 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 ROHS 认证、ECO 认证等诸多国际认证，产品已经得到了欧司朗、三星、LG、索尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片制造、测试系统的综合实力，保证了产品品质的优良和稳定，是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户的保障。

#### 5、优秀的人才队伍

公司已拥有一支超过 350 人的集成电路芯片设计研发队伍、将近 800 人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍。公司还建立了较为有效的技术管理和激励制度，保证人才队伍的稳定，为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。

### (三) 经营计划

#### 1、公司的产品线规划

2016 年公司产品线将按七个方面进行规划、管理和运行：电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、MCU 产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED 器件产品线等。

#### 2、对 2016 年营业总收入的预计

2015 年，公司实现营业总收入 19.26 亿元，完成收入计划的 91.71%。预计 2016 年实现营业总收入 22 亿元左右（比 2015 年增长 15%左右），营业总成本将控制在 21 亿元左右。

上述预计不构成对本公司的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大，前些年发生的全球性金融危机、欧债危机等都对半导体行业产生了较大影响。目前全球经济增长出现了明显的分化。一方面，美国经济形势总体向好，美联储已停止实施量化宽松政策并已进行首次加息。另一方面，欧元区国家、日本等发达经济体的经济增长未有明显改善、甚至更为疲弱，欧洲央行和日本央行均加大了量化宽松政策的力度，实施了“负利率”政策；同时，经济发达国家实施的超宽松货币政策所带来的货币溢出效应也对新兴国家形成了明显冲击，由于自身及外部因素，金砖国家为代表的新兴经济体的经济增速已明显放缓。对于宏观风险，公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产营运的效率；将进一步拓宽融资渠道、把握好资本运用的节奏，降低债务杠杆。

## 2、行业周期风险及其对策

半导体行业存在明显的行业周期。近年来，随着技术发展和应用领域更新加速，行业周期呈现缩短趋势。对于行业周期风险，公司将抓住国家大力支持国内集成电路产业发展的有利时机，坚持并完善 IDM 发展模式，通过加大对产品、技术研发的投入、加强市场推广和品牌建设，把握好固定资产投资节奏，从而实现可持续发展。

LED 子行业近年来呈现出竞争加剧的情况，有部分规模中小型的下游客户抵御风险的能力较弱，容易受到宏观经济的影响出现现金流紧张的情况，导致 LED 芯片提供商的应收款风险增加。公司将加大对 LED 应收款风险的识别，加大对下游客户生产经营情况的跟踪力度，同时公司亦将加大对重要品牌客户的开拓和维护，以降低该等风险。

## 3、新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快，公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需求的节奏，公司将浪费较大的资源，并丧失市场机会，不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险，公司将充分结合 IDM 模式（设计与制造一体化）的优势，加大对高端功率半导体芯片、MEMS 器件和传感器等新产品的研发投入，加快推出契合市场的新产品，“持之以恒、做精做专”，深挖细分市场空间。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

### 议案之三：

## 2015 年度监事会工作报告

本议案已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十四次会议于 2015 年 3 月 8 日召开	审议通过了（1）2014 年年度报告及摘要；（2）《2014 年度监事会工作报告》；（3）《2014 年度财务决算报告》；（4）《关于 2014 年度利润分配的预案》；（5）《杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年度关于公司内部控制有效性的自我评估报告》；（6）《杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年度社会责任报告》；（7）《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；（8）《关于 2014 年年度报告审核意见的议案》。
第五届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 29 日召开	审议通过了 2015 年第一季度报告并出具了相应的审核意见。
第五届监事会第十六次会议于 2015 年 5 月 31 日召开	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届监事会第十七次会议于 2015 年 6 月 26 日召开	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届监事会第十八次会议于 2015 年 8 月 16 日召开	审议通过了（1）2015 年半年度报告及摘要；（2）《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届监事会第十九次	审议通过了 2015 年第三季度报告并出具了相应的审

会议于 2015 年 10 月 29 日召开	核意见。
---------------------------	------

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范。天健会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内：公司出售资产履行了相应的手续，价格合理；没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。同意《2015 年度内部控制的自我评价报告》。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之四：

### 2015 年度财务决算报告

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 一、2015 年与 2014 年主要财务数据的增减对比

(单位：人民币万元)

项 目	2015年		2014年		增减对比(%)	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
总资产	334,326	434,100	310,307	401,816	7.74	8.03
资产负债率(%)	30.36	44.28	26.44	39.89	3.91	4.38
股东权益	232,830	241,893	228,247	241,516	2.01	0.16
总股本	124,717	124,717	124,717	124,717	-	-
每股净资产(元)	1.87	1.94	1.83	1.94	2.01	0.16
营业收入	130,106	192,641	118,030	187,003	10.23	3.02
营业利润	6,476	-4,105	12,533	11,647	-48.33	-135.25
利润总额	7,906	2,804	16,436	18,502	-51.90	-84.85
净利润	8,476	4,157	16,374	16,707	-48.24	-75.12
每股收益(元)	0.07	0.03	0.13	0.13	-48.24	-75.12
净资产收益率(%)	3.64%	1.72%	7.17%	6.92%	-49.25	-75.16

#### 二、损益情况

2015 年公司营业收入为 192,641 万元，同比增长 3.02%；

2015 年公司营业成本为 141,259 万元，同比增长 7.08%；

2015 年公司营业税金及附加 1,221 万元，同比增长 13.11%；

2015 年公司期间费用合计 56,452 万元，同比增加 9,502 万元，增长比率为 20.24%。其中销售费用同比增加 596 万元，增长比率为 12.29%；管理费用同比增加 1,859 万元，增长比率为 5.19%；财务费用同比减少 1,251 万元，下降比率为 29.56%；资产减值损失同比增加 8,298 万元，增长 4.13 倍。

2015 年公司销售费用增加的主要原因系为保持和扩大市场占有率而投入的销售支出增长所致。

2015 年公司管理费用增加的主要原因系研发投入和人力费用正常比例增加所致。

2015 年公司财务费用减少主要原因系受美元对人民币汇率走强的影响，使

得本期汇兑收益大幅增加所致。

2015 年公司资产减值损失大幅增加主要原因系子公司士兰明芯公司计提大额坏账准备和存货跌价准备。

2015 年公司营业利润-4,105 万元，同比下降 135.25%，主要原因系销售毛利的下降和资产减值计提的增加所致；利润总额为 2,804 万元，同比下降 84.85%；所得税费用为-1,353 万元，同比减少 175.38%，主要原因系一方面本期所得税利润减少，另一方面亏损子公司士兰明芯公司确认递延所得税资产所致；净利润为 4,157 万元，同比下降 75.12%。

### 三、资产、负债、权益情况

2015 年末公司总资产同比增加 32,285 万元，增长比率为 8.03%。流动资产减少 46 万元，其中：货币资金减少 7,787 万元，下降比率为 15.98%；应收票据减少 1,041 万元；应收账款增加 3,160 万元，增长比率为 6.21%；其他应收款增加 482 万元；存货增加 6,000 万元，增长比率为 9.03%；其他流动资产减少 1,289 万元。非流动资产增加 32,331 万元，其中：可供出售金融资产增加 1,000 万元，增长 3.59 倍；长期应收款增加 200 万元，增长比率为 66.67%；长期股权投资减少 2,270 万元，下降比率为 21.88%；固定资产增加 11,894 万元，增长比率为 11.04%；在建工程增加 16,727 万元，增长比率为 43.43%；无形资产减少 407 万元；长期待摊费用减少 527 万元，下降比率为 45.70%；递延所得税资产增加 1,930 万元，增长比率为 34.66%；其他非流动资产增加 3,784 万元，增长 10.55 倍。

2015 年货币资金减少的主要原因系本期固定资产投资项目增加所致。

2015 年其他应收款增加的主要原因系本期应收暂付款增加所致。

2015 年可供出售金融资产增加的主要原因系本期新增对上海安路信息科技有限公司投资所致。

2015 年长期应收款增加的主要原因系子公司士兰明芯公司融资租赁业务保证金所致。

2015 年长期股权投资减少的主要原因系本期联营企业杭州友旺电子有限公司发放现金股利以及对 Op Art Technologise, Inc. 全额计提减值准备，使得权益法核算下减少长期股权投资所致。

2015 年固定资产、在建工程增加的主要原因系本期 8 英寸芯片项目、成都

士兰一期工程等项目新增资产投入所致。

2015 年长期待摊费用减少的主要原因系本期费用摊销所致。

2015 年递延所得税资产增加的主要原因系本期资产减值准备、可抵扣亏损增加所致。

2015 年其他非流动资产增加的主要原因系本期待确认的售后租回损益增加所致。

2015 年末公司流动负债同比增加 26,364 万元，增长比率为 21.23%。其中：短期借款同比减少 2,000 万元，下降比率为 3.81%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比减少 7,082 万元，下降比率为 46.39%；应付票据减少 2,082 万元，下降比率为 16.18%；应付账款增加 3,049 万元，增长比率为 10.21%；预收款项增加 136 万元；应交税费减少 841 万元，下降比率为 45.76%；应付利息减少 106 万元，下降比率为 10.95%；其他应付款增加 174 万元，增长比率为 38.66%。

2015 年公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少的主要原因系本期士兰集成减少黄金租赁融资业务所致。

2015 年预收款项增加的主要原因系期末预收货款增加所致。

2015 年应交税费减少的主要原因系期末应交企业所得税和增值税减少所致。

2015 年应付利息减少的主要原因系期末未结借款利息减少所致。

2015 年其他应付款增加的主要原因系期末应付代垫款增加所致。

2015 年末公司非流动负债同比增加 5,544 万元，增长比率为 15.36%。其中：长期借款增加 12,013 万元；应付债券减少 11,487 万元；长期应付款增加 5,112 万元，增长 2.76 倍；递延收益减少 84 万元；递延所得税负债减少 10 万元。

2015 年应付债券减少的主要原因系该债券至到期日少于一年，转入一年内到期的非流动负债所致。

2015 年长期应付款增加的主要原因系期末应支付售后回租形式的融资租赁款增加所致。

#### 四、现金流量情况

从报告年度现金流量表分析，2015 年公司现金及现金等价物净增加额为 -879 万元。其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 20,151 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-44,941 万元。投资活动产生的现金流入为 42,025 万元，主要系收回理财资金 32,600 万元，外汇掉期业务质押的定期存款到期收回 5,027 万元，关联方友旺电子公司投资分红 2,000 万元，收到的各种理财、掉期业务收益 1,046 万元，收到设备及基础设施建设补助 887 万元；投资活动产生的现金流出为 86,966 万元，主要系支出理财资金 32,300 万元，对外直接投资 1,000 万元，购买固定资产、无形资产支付现金 53,439 万元，支付远期结售汇保证金 227 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 22,912 万元。筹资活动产生的现金流入为 109,131 万元，主要系借款收到的现金 89,781 万元，黄金租赁融资交易收到的现金 8,104 万元，收回黄金租赁融资交易保证金 1,024 万元，售后租回融资租赁交易收到的现金 10,000 万元，收到贷款贴息 222 万元；筹资活动产生的现金流出为 86,219 万元，主要系偿还借款 60,000 万元，支付现金股利 3,118 万元，支付借款利息 5,147 万元，支付融资租赁租金 2,311 万元，支付贷款保证金 200 万元，支付黄金租赁融资交易融资款 15,034 万元，支付黄金租赁保证金 387 万元。

## 五、财务相关指标情况

项 目	行次	单位	2015年度		2014年度	
			母公司	合并	母公司	合并
主营业务利润率	1	%	<b>13.50</b>	<b>25.76</b>	14.68	28.71
总资产报酬率	2	%	<b>3.16</b>	<b>1.73</b>	6.37	5.93
资本收益率（全面摊薄）	3	%	<b>6.80</b>	<b>3.33</b>	13.13	13.40
净资产收益率（全面摊薄）	4	%	<b>3.64</b>	<b>1.72</b>	7.17	6.92
资产负债率	5	%	<b>30.36</b>	<b>44.28</b>	26.44	39.89
流动比率	6	%	<b>129.97</b>	<b>149.48</b>	178.22	181.25
速动比率	7	%	<b>106.14</b>	<b>101.36</b>	141.77	127.74
应收帐款周转率	8	次	<b>3.96</b>	<b>3.63</b>	4.15	3.82
存货周转率	9	次	<b>4.74</b>	<b>2.02</b>	5.00	2.23
补充资料：	10					
平均资产总额	11	万元	<b>322,317</b>	<b>417,958</b>	320,921	407,601
平均应收帐款余额	12	万元	<b>32,722</b>	<b>52,432</b>	28,283	48,705
平均存货成本	13	万元	<b>23,504</b>	<b>69,467</b>	19,983	58,965



2015 年公司主营业务利润率比 2014 年下降 2.95 个百分点，主要原因系销售价格下降使得销售毛利减少所致。

2015 年公司总资产报酬率较 2014 年下降 4.20 百分点，资本收益率比 2014 年下降 10.06 个百分点，净资产收益率比 2014 年下降 5.20 个百分点，主要原因系 2015 年公司净利润比 2014 年减少 75.12%。2015 年公司净利润减少的主要原因一方面系销售毛利下降，另一方面系子公司士兰明芯公司本期发生的营业亏损所致。

2015 年公司资产负债率比 2014 年上升 4.38 个百分点。

2015 年公司流动比率比 2014 年下降 31.77 个百分点，速动比率下降 26.38 个百分点。

2015 年公司应收账款周转次数比 2014 年下降 0.18 次，周转天数增加约 5 天；2015 年公司存货周转次数比 2014 年下降 0.21 次，周转天数增加约 17 天，主要系存货增加超过了销售增长使得库存周转速度下降。

综上所述，公司在扩大固定资产投资的同时，要协调好产能利用和销售增长的关系，做好存货、应收账款的风险控制，进一步提高资金流动性来提升公司的市场竞争力，从而为公司拓展市场，创造更大的盈利空间。

（本文数据因为四舍五入的原因，可能跟年度报告有尾数的差异）

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之五：

### 2015 年度利润分配方案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共实现归属于母公司股东的净利润 39,876,203.52 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 8,476,158.80 元后，当年可供股东分配的利润为

31,400,044.72 元，加上上年结转未分配利润 845,013,224.80 元，再减去报告期内已经派发的 2014 年度现金股利 3,117.92 万元，截至期末累计可供股东分配的利润为 845,234,069.52 元。

本公司 2015 年度的利润分配的方案为：拟以 2015 年度末公司注册资本 124,716.8 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发现金股利 12,471,680 元。剩余 832,762,389.52 元转至以后年度分配。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之六：

### 关于与友旺电子日常关联交易的议案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2015 年初，本公司预计 2015 年度本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）与关联企业杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）2015 年度累计交易金额将不超过 2 亿元人民币。2015 年度，士兰集成与友旺电子实际累计交易达 1.3 亿元人民币，未超过 2015 年度交易额 2 亿元人民币的预计。

士兰集成拟与关联企业友旺电子签订 2016 年《委托加工协议书》。根据公司章程的规定，上述委托加工协议的生效须获得董事会及股东大会批准。杭州友旺电子有限公司是杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，有着长期良好的合作关系。

双方拟签订的委托加工协议的全部条款都是依据公平交易的原则确定的，在该委托加工协议书中约定的交易行为均属正常的商业行为。据初步计算，杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司 2016 年的累计交易金额将不超过 2 亿元人民币。

自 2016 年 1 月 1 日起，至 2015 年度股东大会召开日前，本公司与友旺电子在本预计范围之内的日常关联交易，公司均认为有效。

陈向东先生和罗华兵先生为关联股东需回避表决，请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之七：

### 关于续聘 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告审计报酬共计 83 万元人民币。公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告境内审计机构，并确定其 2016 年度财务报告审计报酬为 83 万元（若有其他事项，报酬另议）。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之八：

### 关于本公司 2016 年度对全资子公司 及控股子公司提供担保的议案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

为满足 2016 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的需要，董事会拟同意在 2016 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 138,000 万元，其中：

- 1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过 60,000 万元；

- 2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过 20,000 万元；
- 3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过 20,000 万元；
- 4、对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过 20,000 万元
- 5、对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过 2,000 万元；
- 6、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过 1,000 万元；
- 7、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过 10,000 万元；
- 8、对成都集佳科技有限公司担保不超过 5,000 万元。

（以上金额包含 2015 年度延续至 2016 年度的担保余额）

在 2015 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之九：

### 关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2015 年度，本公司董事长陈向东先生领取董事长报酬 74.9 万元。

根据 2012 年 12 月 16 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议：第五届董事会独立董事裴长洪先生、金小刚先生、朱大中先生、黄先海先生、冯晓女士各领取独立董事津贴的标准为：6 万元/年（含税）。以上独立董事中除黄先海先生、裴长洪先生外，在本年度均已按照规定领取了相应的津贴。其中独立董事黄先海先生自愿放弃领取其自 2015 年 1 月 1 日起的独立董事津贴，裴长洪先生于 2015 年 4 月 30 日辞去了独立董事的职务，故领取了独立董事报酬 2 万

元。

2015 年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事报酬。

本议案由公司董事会薪酬及提名委员会审议通过并提交。

（说明：副董事长郑少波先生担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 76.8 万元；副董事长范伟宏先生，担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由士兰集成发放，共计 75 万元；董事江忠永先生，担任子公司杭州美卡乐光电有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由士兰明芯及美卡乐发放，共计 74.8 万元；董事李志刚先生，担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由深兰微发放，共计 105.2 万元；监事会主席宋卫权先生担任本公司设计所所长，未在本公司领取监事报酬，领取设计所所长职务报酬 67.6 万元；监事陈国华先生，担任控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理，未在本公司领取监事报酬，其报酬由成都士兰发放，共计 60 万元；监事胡铁刚先生，担任本公司产品线总经理，未在本公司领取监事报酬，领取产品线总经理职务报酬 40.9 万元。

2015 年度本公司董事罗华兵先生不在本公司及控股子公司领取报酬，其在杭州友旺电子有限公司领取报酬。）

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

## 议案之十：

### 关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请公司 2015 年年度股东大会审议。

公司于 2015 年 5 月 5 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》，拟使用最高不超过人民币 4 亿元的自有暂时闲置资金（本金）进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用冗余资金购买银行理财

产品累加的金额不超过 20 亿元人民币。

公司多次利用资金使用的间隙滚动使用资金购买理财产品，2015 年度获得实际收益约 785 万元人民币（包含 2014 年度购买但 2015 年度到期的理财产品，不包含截至报告期末尚未到期的收益）。

为了提高资金收益，降低财务费用、公司拟继续合理利用暂时冗余的资金进行低风险的短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

## 一、基本概况

### 1、投资额度

在未来十二个月内，公司拟提请股东会同意公司（包含下属控股子公司，下同）可以使用最高不超过人民币 5 亿元的自有暂时闲置资金（本金）进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用冗余资金后累加的金额不超过 20 亿元人民币。

### 2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365 天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。

### 3、投资期限

投资期限自本决议作出之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 365 天。

### 4、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

## 二、风险控制措施

1、待公司董事会提交股东大会后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5、公司将依据上交所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日